

ATM-12000DR

全自動ウェーハマウンター
(保護テープ剥離内蔵)
Automatic Wafer Mounter
(with Detape function)

【概要 - Outline -】

- ◆本装置は8インチ、12インチウェーハをダイシングフレームにマウントした後、
The ATM-12000DR is ideal system for mounting 8", 12" wafers to dicing frame and then removing protective tape.
ウェーハ表面より保護テープを剥離する全自動機です。

【特長 - Features -】

- ◆ウェーハを真空中で貼付けるため気泡の混入がなく貼付けが可能です。
Capable of handling 12" 150 μ thickness wafer and aligning precisely.
また、低荷重での貼付けが可能となり、ウェーハにダメージを与えません。
- ◆保護テープ剥離に独自に先端ヒートプレス方式の採用により、安定した剥離が可能です。
Vacuum chamber application eliminates air bubbles and less damage wafers.
- ◆ロールタイプ/プリカットタイプダイシングテープの共用仕様にも対応可能。(オプション)
Removing without any stress to wafer by unique method.



| | |
|----------------------|--|
| 仕様 Specification | ATM-12000DR |
| スループット Throughput | 50枚/h (ご使用条件により異なります Depend on data setting) |
| 対応ウェーハサイズ Wafer Size | 8・12 inch |
| フレームサイズ Frame Size | 2-8-1 / 2-12-1 |
| 使用テープ幅 Tape Width | 8 inch : W 300 mm / 12 inch : W 400 mm |
| ユーティリティ | 電源 Power AC200V 3相 3phase 50/60Hz 13KVA |
| Utilities | 空気源 air 圧力 Pressure 0.5Mpa 200NI/min |
| 装置寸法 Demension | W 1,800 × D 2,800 × H 1,800 mm |
| 重量 Weight | 2,000 kg |

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.